2026 RESEARCH FORUM

하나TV
하나증권

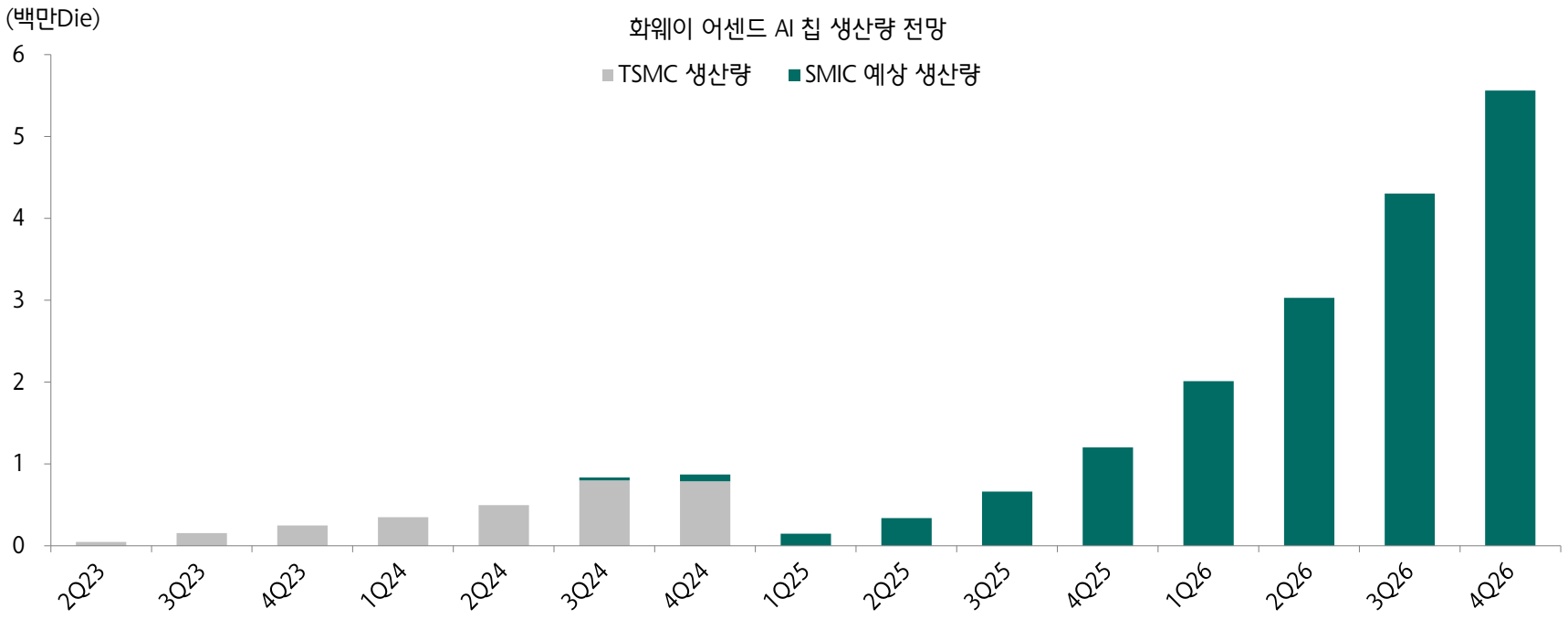
중국 투자 유망종목 | 중국기업분석 백승혜

중국의 AI 굴기는 2026년에도 계속된다

하나증권

은밀하고 빠르게, 그리고 필사적으로 진행 중인 중국의 AI 굴기

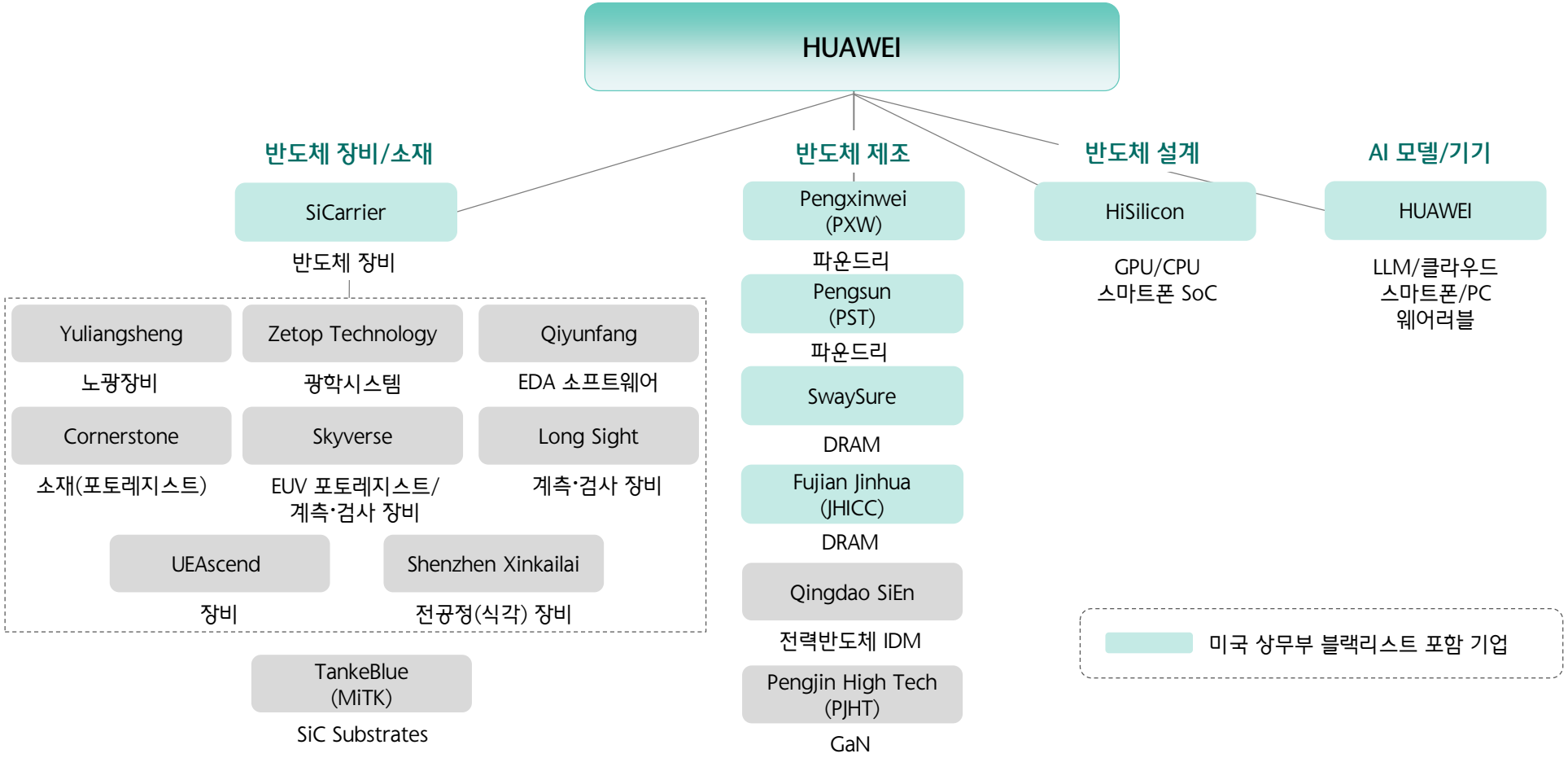
- 2026년에도 중국의 AI 산업은 기술 자립을 위한 정부의 정책적 지원과 국산화 진전이 지속되며 주식시장의 핵심 테마로 주목받을 전망
- 정부 지원을 바탕으로 반도체 자체 공급망을 완성한 화웨이와 함께 SMIC, CXMT가 첨단 AI 칩과 HBM3 대규모 양산을 시도할 예정
- 2026년 중국 AI 산업 투자 유망 섹터는 올해 주가 랠리로 고평가된 팹리스/파운드리 업종보다는 ESS/전력망/소프트웨어 섹터를 추천



자료: SemiAnalysis, 하나증권

화웨이의 첨단 반도체 비공식 네트워크

전 세계에서 유일하게 'AI 공급망 전반'을 구축한 기업



자료: Quantiwise, 하나증권

화웨이 컴퓨팅 클러스터로 가늠해본 중국의 AI 컴퓨팅 역량

- 최신 AI 컴퓨팅 클러스터 'Cloud Matrix 384'는 엔비디아의 GB200 NVL72보다 5배 이상 많은 AI 칩과 메모리를 탑재
- 전력소모 4배, 가격 2.7배 높지만, 전체 시스템 레벨에서 엔비디아 대비 1.7배의 연산능력과 2배 이상의 메모리 성능 확보
- 단일 칩의 부족한 성능을 '스케일'과 중국의 풍부하고 저렴한 '전력'으로 상쇄함으로써 AI 컴퓨팅의 성능 한계를 극복하려는 시도 중

화웨이 Vs. 엔비디아 최신 AI 컴퓨팅 클러스터 성능 비교

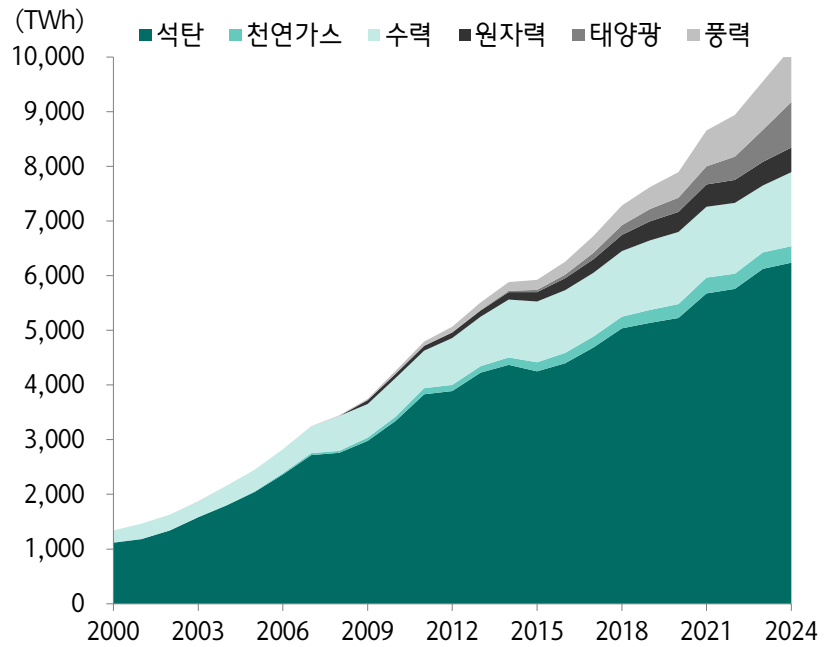
칩/패키징 레벨				
	단위	GB200	Ascend 910C	엔비디아 대비 화웨이 성능
연산능력	TFLOPS(BF16)	2,500	780	0.3배
HBM 용량	GB	192	128	0.7배
HBM 대역폭	TB/s	8	3.2	0.4배
시스템 레벨				
	단위	GB200 NVL72	Cloud Matrix CM384	엔비디아 대비 화웨이 성능
연산능력	PFLOPS(BF16)	180	300	1.7배
HBM 용량	TB	13.8	49.2	3.6배
HBM 대역폭	TB/s	576	1,229	2.1배
총 전력소모	W	145,000	599,821	4.1배

주: 총 전력소모는 스케일-아웃 네트워킹, 스토리지를 포함한 전체 컴퓨팅 클러스터 전력 소모량을 의미
자료: SemiAnalysis, 하나증권

중국의 풍부한 전력은 AI 데이터센터 확대에 큰 장점으로 작용

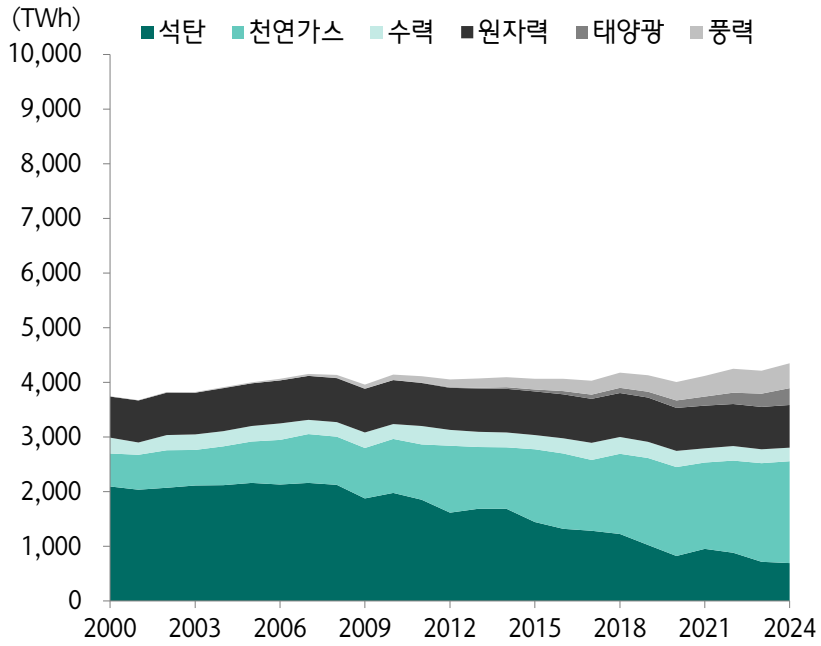
- 중국은 현재 전 세계 최대 전력 생산 국가로 지난 10년간 미국의 전체 전력 생산량 만큼의 발전용량을 추가로 확대
- 미국은 전력 수요 정체와 화력 발전 축소 등으로 발전량이 최근 20년 이상 정체, 데이터센터 전력 수요 급증으로 전력 부족에 직면
- 미국은 주정부/민간기업 사이의 인허가, 전력 배분 등 문제로 신규 공급이 크게 지연(버지니아 북부 신규 DC는 최대 7년 소요 전망), 반면 중국은 중앙정부 주도로 원자력/신재생 중심의 신규 전력 공급을 빠르게 확대 중

중국 전력 발전량 – 지난 20년간 9배 이상 확대



자료: 중국 국가통계국, SemiAnalysis, 하나증권

미국 전력 발전량 – 2007년 이후 전력 수요 0% 수준으로 정체

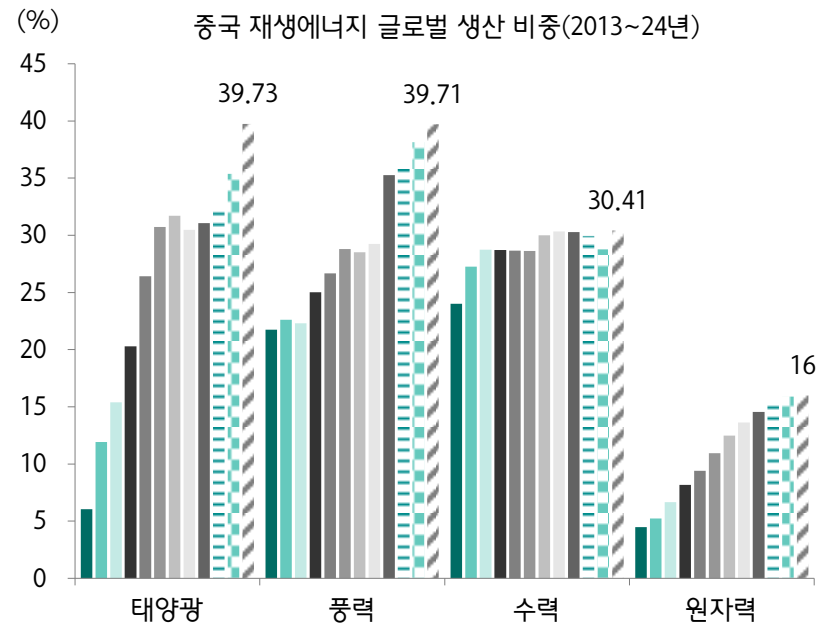


자료: EIA, SemiAnalysis, 하나증권

신재생 생산량 비중도 글로벌에서 압도적

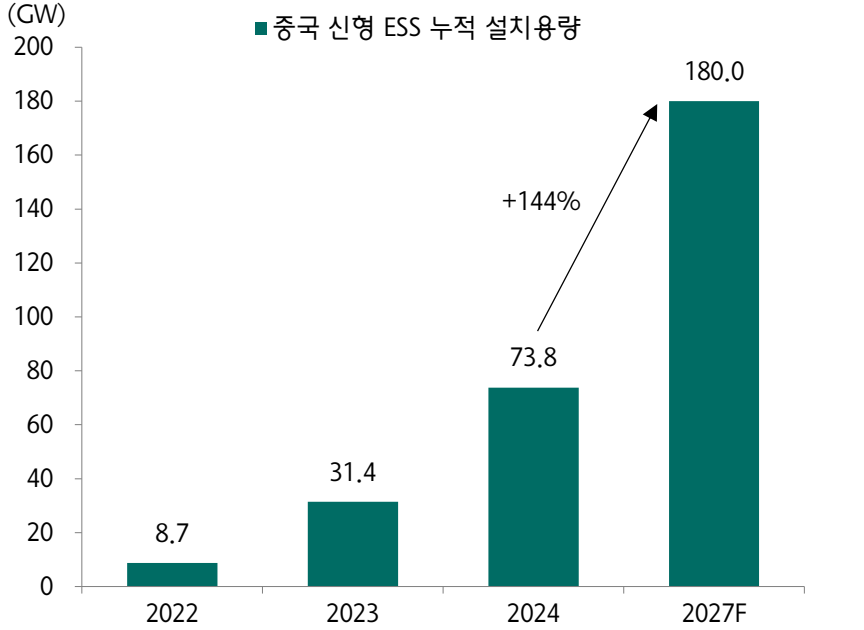
- 중국은 태양광/수력/풍력 발전량도 글로벌 1/3 수준, 2024년 신규 발전 설비의 86%가 재생에너지로 구조 전환 가속화 중
- ESS 누적 설치용량은 2024년 74GW(YoY +135%)로 글로벌 점유율 43%, 2027년 180GW로 2024년 대비 2.44배 확대 목표
- 중국은 '25년까지 신재생으로 신규 DC 전력의 80% 공급 목표, '35년 전체 DC 전력 공급의 약 60% 신재생/원자력이 차지할 전망

중국 재생에너지 발전량 전 세계에서 가장 빠르게 증가



주: 발전용량 기준
자료: Wind, 하나증권

중국 신형 ESS 설치용량 - 2027년까지 2.44배 확대 목표

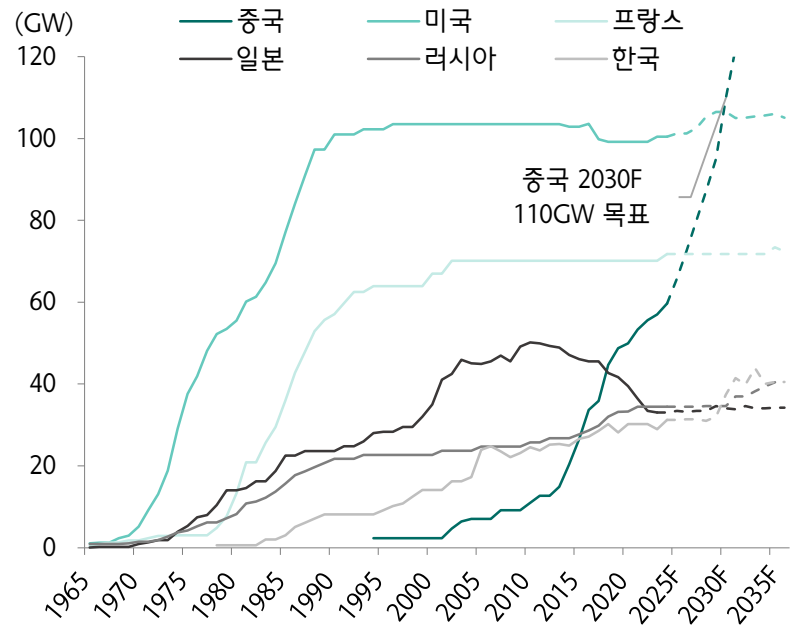


주: 신형 에너지 저장(New type Energy Storage)은 펌프 수력 저장(PHS)을 제외하고 주로 배터리 기반 BESS 저장장치를 의미
자료: 중국에너지국, CNESA, 하나증권

전 세계에서 가장 공격적으로 원전을 확대 중인 중국

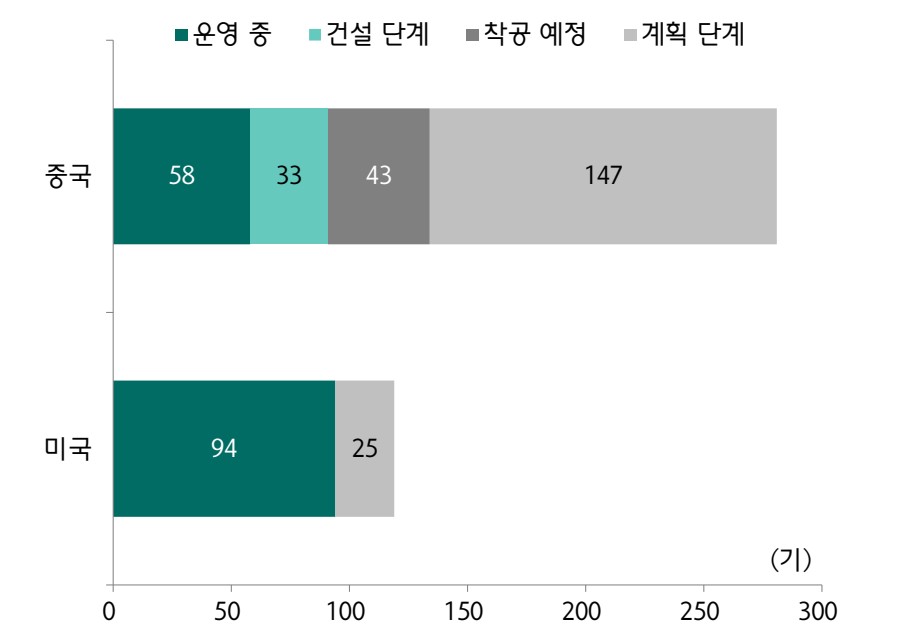
- 2025년 10월 기준 중국의 원전 발전용량/원자로 규모는 2013년 대비 4배/3배로 급격히 증가한 반면 미국은 동기간 감소
- 원자력은 중국의 탄소중립에 필수적이자, 석탄/태양광(3~4천시간/연간) 대비 가동시간(7천+) 길어 AIDC 전력 공급에 적합
- 현재 전 세계에서 건설 중인 원자로의 50% 이상이 중국, 2030년 발전용량이 미국을 추월하는 글로벌 1위 달성이 정부의 목표

글로벌 원자력 발전 용량 전망



주: 2015년 전후 중국은 전력 수요 급증과 대기오염 문제로 원전 발전량을 크게 확대
자료: Global Energy Monitor(2024), 하나증권

향후 건설 예정인 원자력 발전소 규모 미국 대비 압도적

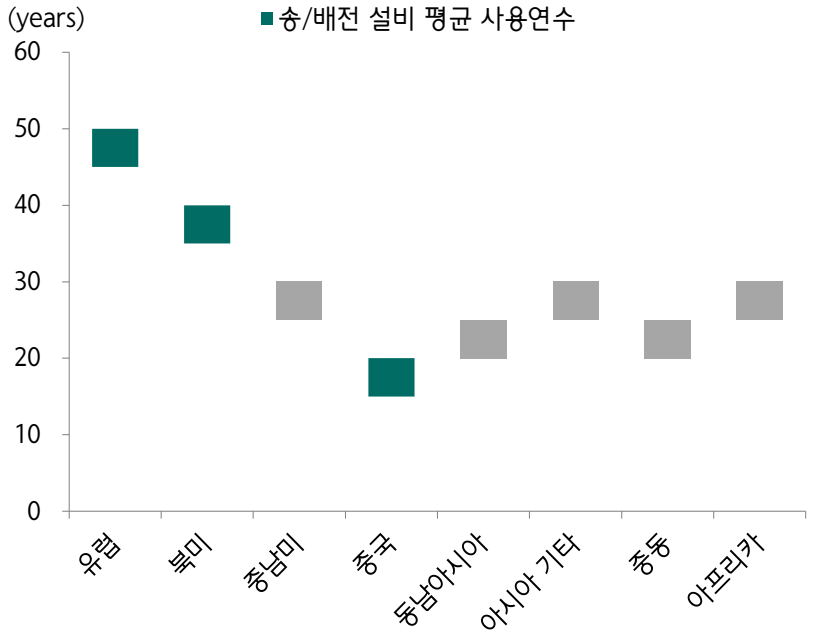


주: 2025년 10월 기준
자료: 세계원자력협회, Wind, 하나증권

선진국보다 젊고, 빠른 초고압 송전망 인프라로 안정적인 전력 보급 가능

- 중국의 송/배전 설비 평균 사용 연한은 20년 미만으로 노후화된 미국(35~40년)과 유럽(>45년) 대비 전력 인프라 안정성 높음
- 14차 5개년 계획(2021~25년) 기간 중앙정부 주도로 45개의 초고압(UHV) 송전망 완공, 서부→동부 장거리 송전 인프라 확보
- 2024년 UHV를 통한 송전 전력의 60%가 신재생 에너지로 2020년 말 대비 70% 증가, 대규모의 신재생 전력 송전 가능

중국 대비 많이 노후화된 미국/유럽의 전력 인프라



자료: Nexans, 하나증권

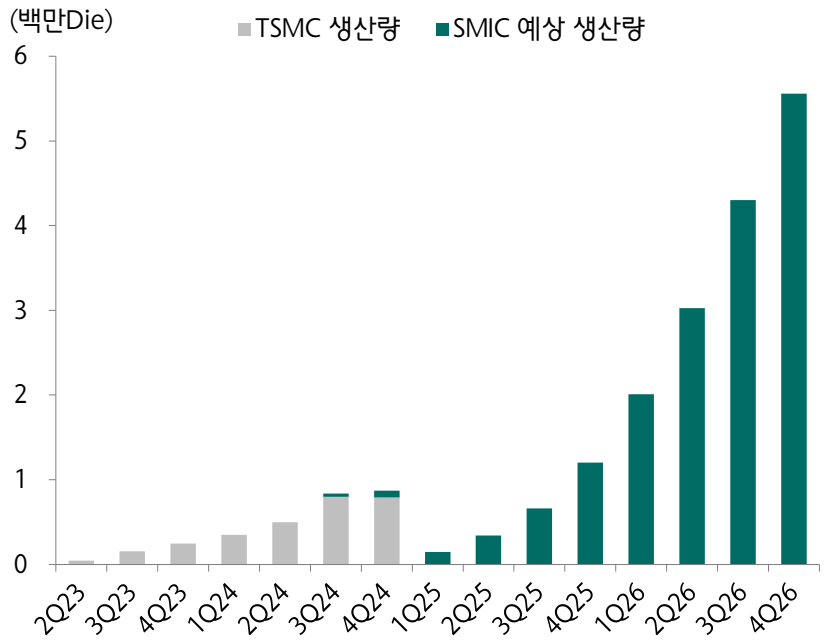
중국 초고압 송전망 – AI 대응 위한 전력망 투자 '24년부터 재차 확대 중

자료: 중국 국가전력망공사, 하나증권

SMIC의 어센드 칩 양산 규모 대폭 확대될 전망

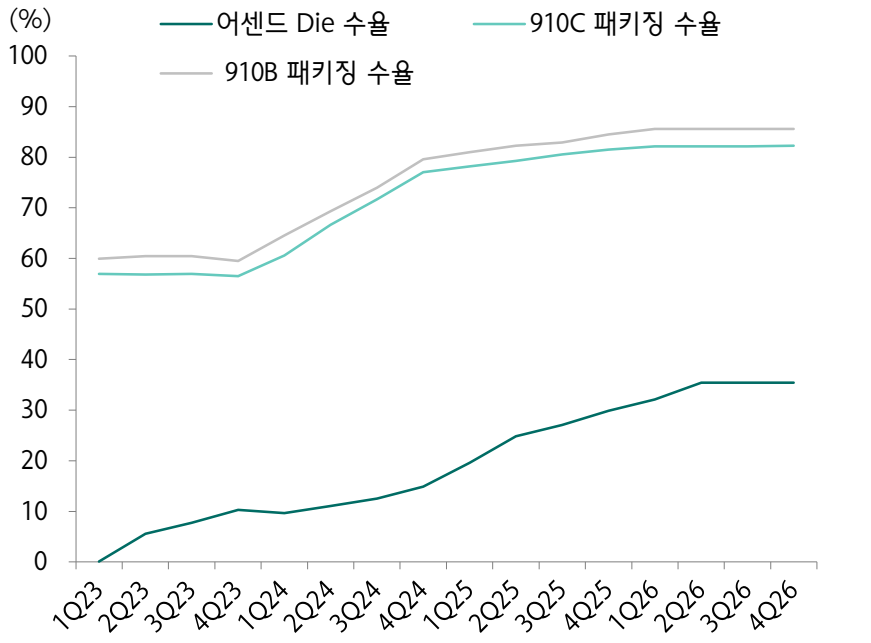
- SemiAnalysis의 추산에 따르면 수백 만개 단위의 어센드 칩 생산에는 최대 월 2만장 수준의 SMIC의 Capa가 필요
- SMIC의 7nm 이하 공정 Capa는 '25년 말 월 4.5만장에서 '26년/'27년 6만/8만장으로 확대되며 어센드 칩 생산도 크게 증가할 전망
- 중국 스마트폰 제조사들이 모바일 SoC 제조를 TSMC로 점차 넘기면서 SMIC의 AI 칩 생산 여력은 수율 개선과 더불어 확대 가능

화웨이 어센드 칩 전체 생산량 – 2026년부터 SMIC가 대량 양산 예정



주: SMIC의 14nm 이하 공정 매출 비중은 2023~24년 10% 미만에서 2025년 15~20%로 확대 추정
자료: SemiAnalysis, 하나증권

SMIC 어센드 생산 수율 – 한 자리 수 개선에도 생산량 크게 확대 가능



자료: SemiAnalysis, 하나증권

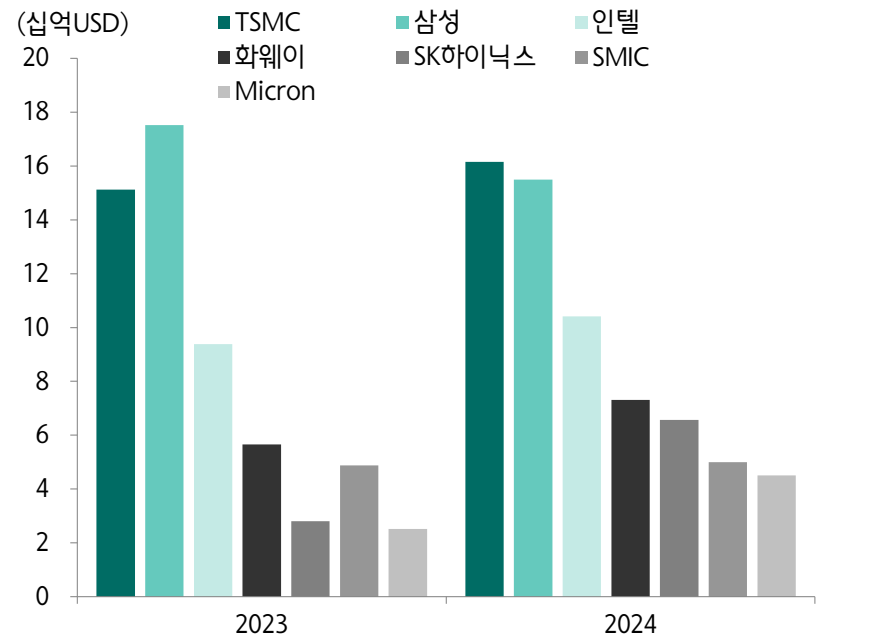
화웨이도 2026년부터 첨단 칩 제조에 합세할 예정

- 비공식적으로 첨단 반도체 공급망을 구축한 화웨이는 2026년부터 7nm 공정의 AI 칩과 모바일 SoC 자체 양산을 시작할 전망
- 중국 선전에 위치한 화웨이 공장 옆에는 장비 제조사인 SiCarrier와 DRAM 제조사인 SwaySure의 공장도 2024년 완공한 상태
- 화웨이의 반도체 장비 지출액은 '22년 제로 수준에서 '24년 73억달러(YoY +27%)로 급증, 2년 만에 글로벌 4대 장비 고객사로 등극

화웨이가 2022년부터 건설 중인 선전 AI 칩 제조공장 위성 사진

자료: FT, 하나증권

글로벌 반도체 장비 지출액 Top 7 기업

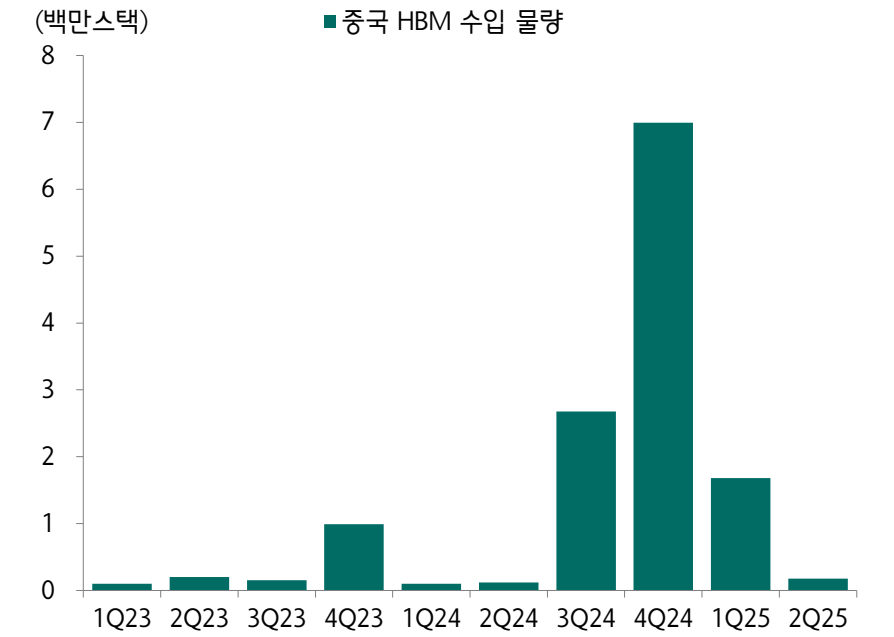


자료: SemiAnalysis, 하나증권

하지만 현재 가장 시급한 문제는 ‘HBM 병목’

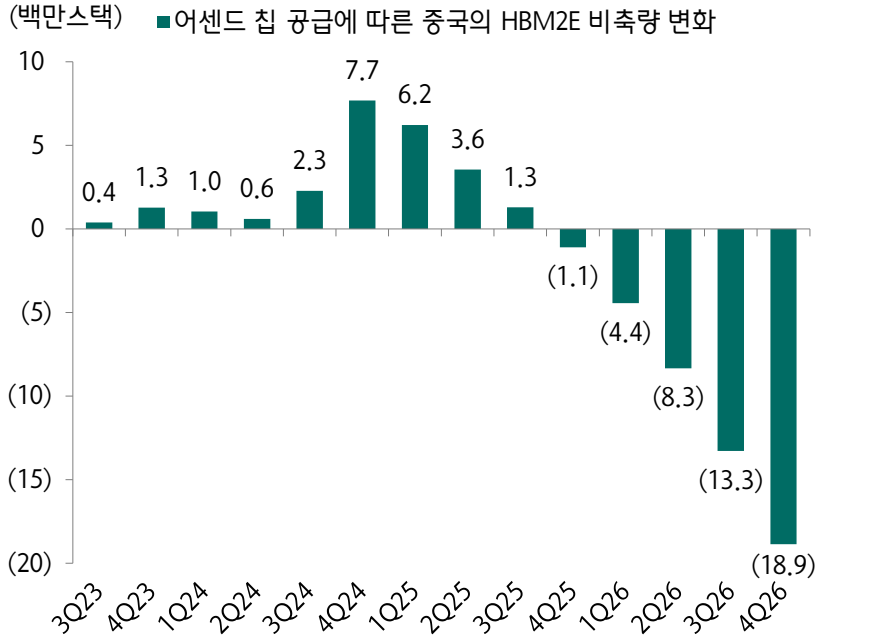
- 2026년 중국 AI 칩 생산을 위해서는 CXMT의 HBM 공급이 필수, CXMT 공급량에 따라 AI 칩 생산량 좌우될 것
- 중국은 2024년 말부터 HBM2e 이상 성능 수입 불가해짐에 따라 4Q24까지 집중 수입, 1H25에도 우회 수입 시도한 것으로 추정
- 다만, HBM 물량이 소진되면 AI 칩 제조 역량이 확대되어도 ASIC 양산 불가, 결국 HBM 부족이 AI 칩 공급 확대에 걸림돌 될 수 있음

미 제재로 2024년 4분기 중국 HBM 수입 물량 급증



자료: SemiAnalysis, 하나증권

중국의 HBM 비축 물량은 곧 소진될 전망

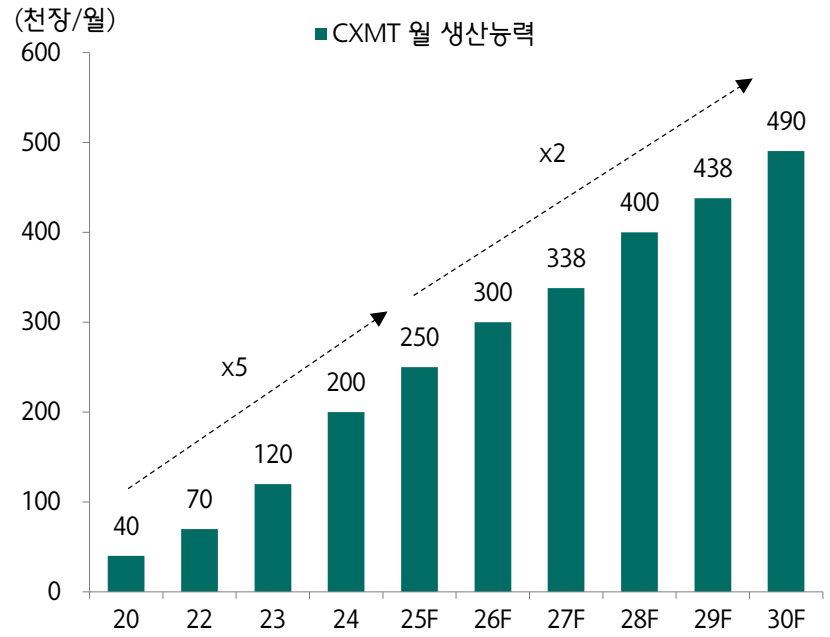


자료: SemiAnalysis, 하나증권

따라서 CXMT는 2026년 HBM3 대규모 양산 개시 목표 중

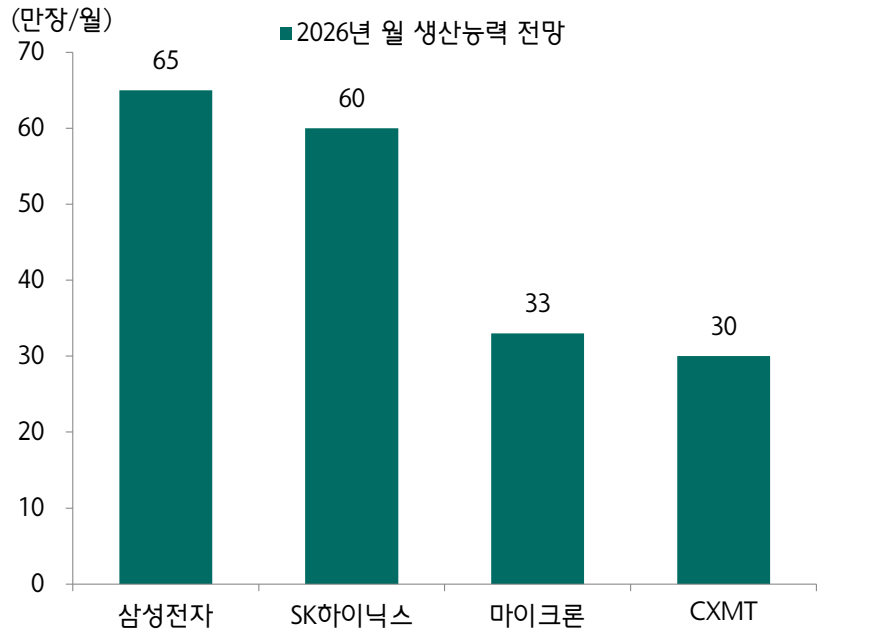
- 대규모 정부 지원을 바탕으로 공격적으로 증설, 월 생산능력은 '25년 기준 5년 사이 5배 확대, '30년까지 2배 가까이 확대 예상
- 글로벌 DRAM 생산 점유율은 '25년 약 15%으로 마이크론에 버금가는 수준, '26년에는 SK/삼성(60만장)의 50%까지 확대 전망
- 올해 DDR4 생산 중단하고 DDR5/HBM에 집중, HBM3는 1H26 양산 개시 목표로 화웨이/협력사에 16nm 공정 샘플 제공한 상태

CXMT DRAM 생산능력 전망



주: 12인치 웨이퍼 환산 기준
자료: Trendforce, Digitimes, SemiAnalysis, 하나증권

CXMT의 DRAM 생산능력은 마이크론 수준까지 추격

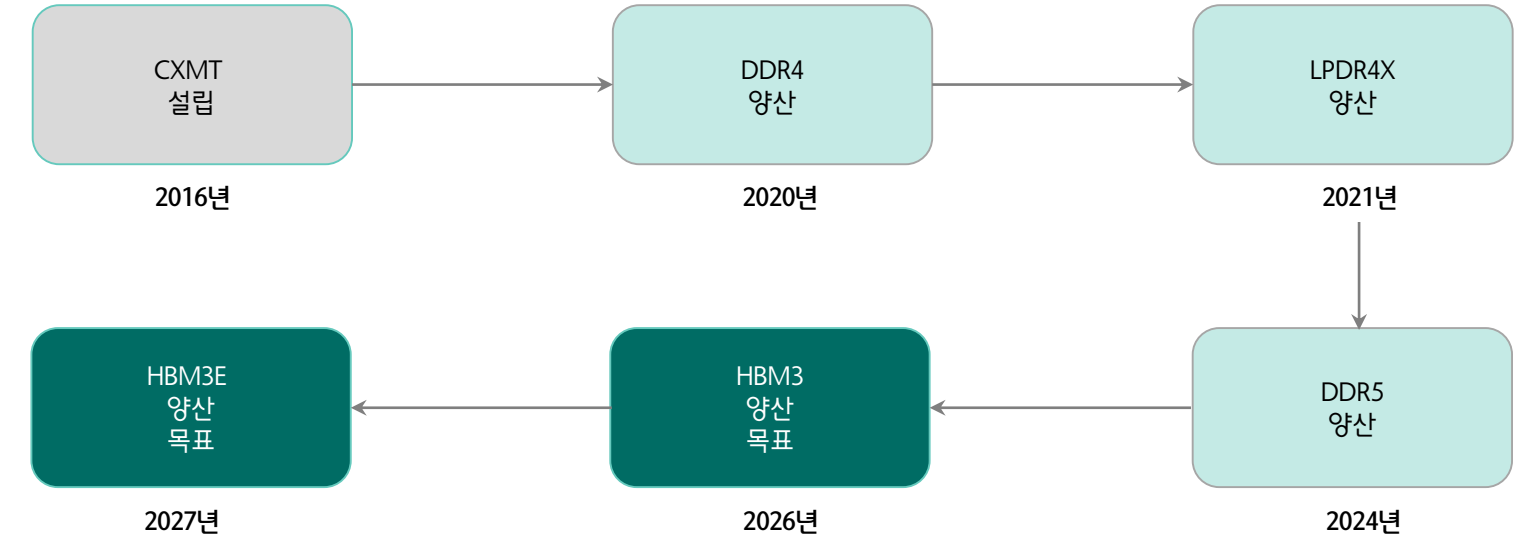


주: 언론 보도 기준 삼성전자는 2026년 월 60만장 중반대로 전망, 마이크론은 월 30만장 초반대로 추정
자료: Trendforce, Digitimes, 하나증권

첨단 TSV 장비와 후공정 기술 돌파 통한 HBM3 수율 개선이 관건

- DDR5 수율은 80% 돌파해 글로벌 선두 수준에 근접, DDR5 양산 경험 통해 '27년 HBM3E 개발 목표 중(글로벌 선두와 3~4년 격차)
- 빠른 기술력 향상은 1)높아진 로컬 엔지니어링 기술, 2)경쟁사 엔지니어 영입, 3)글로벌 장비업체 sub-process 기술 획득 등에 기반
- HBM3 수율 40% 돌파가 관건, 현재 일본의 TSV 첨단 장비 확보 중이며 로컬 후공정 업체(JCET/통푸)가 TSV/적층 연구에 집중 중

CXMT의 DRAM 기술 개발 추이

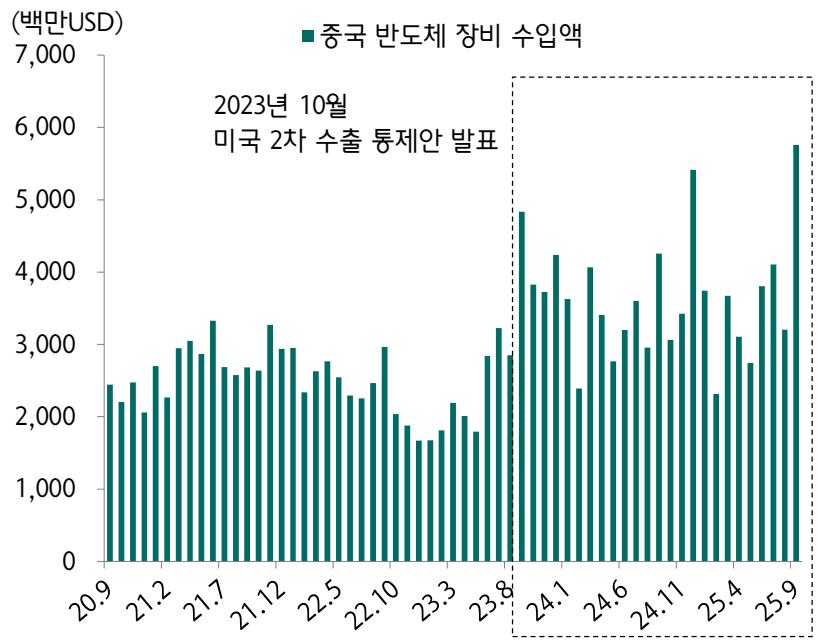


자료: Digitimes, 언론 보도, 하나증권

대규모 증설 진행해 제조 역량 빠르게 확대한 중국 SMIC

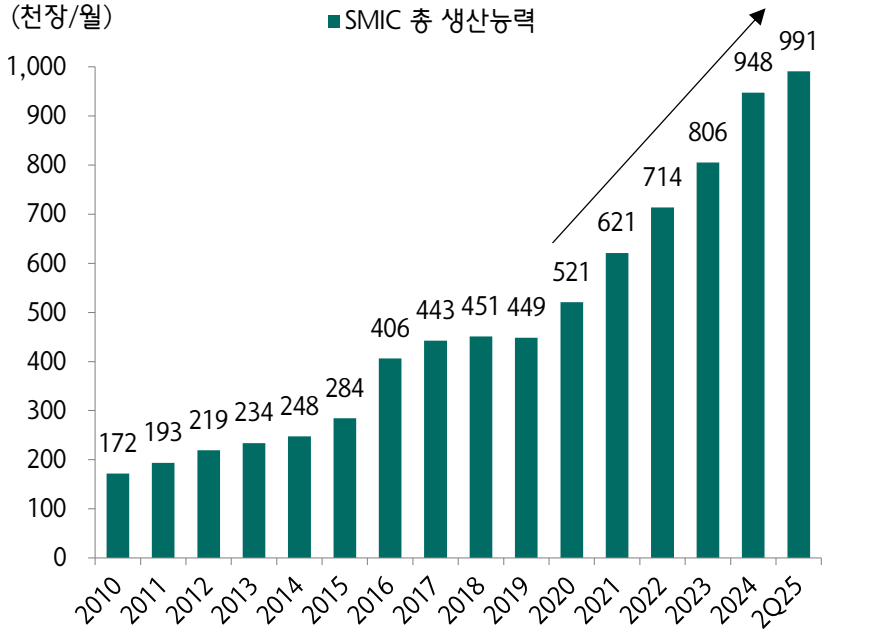
- 중국은 2023년 10월 미국의 2차 대중국 반도체 수출 통제안 발표를 기점으로 미국과 동맹국으로부터 첨단 장비 집중적으로 축적
- SMIC는 미국 블랙리스트에 포함된 2020년 이후로 오히려 공격적인 증설에 성공, 2Q25 생산능력은 2020년 대비 2배 수준 확대
- 특히 ASML의 노광장비, TEL의 트랙장비, KLA의 검사/계측장비 등 로컬 대체가 불가능한 해외 장비에 중국 업체들의 투자가 집중

중국 반도체 장비 수입



자료: CEIC, 하나증권

SMIC 총 생산능력 추이

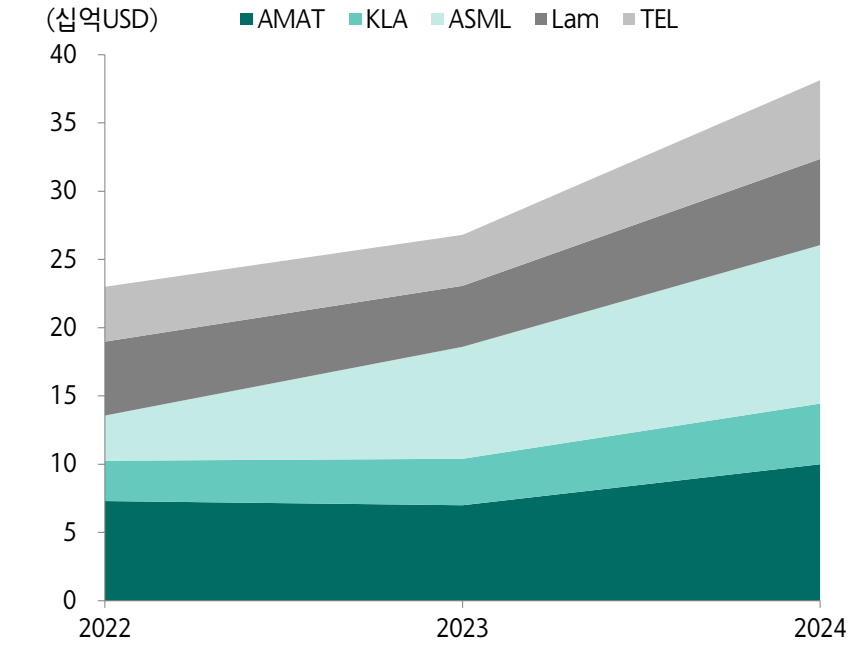


주: 8인치 웨이퍼 환산 기준
자료: SMIC, 하나증권

미국 규제 이후 글로벌 5대 장비사 중국 매출은 더욱 증가

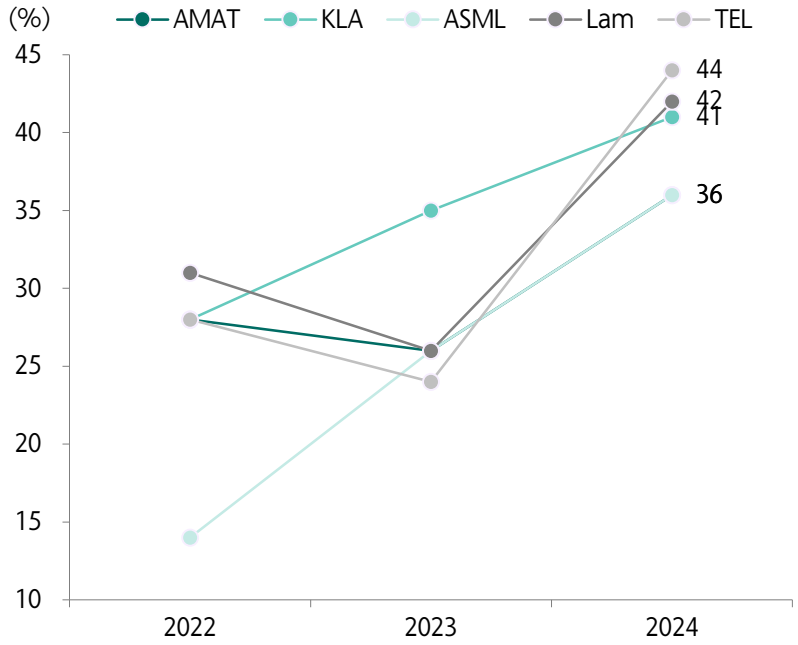
- 글로벌 5대 반도체 장비사의 중국 매출액은 2024년까지 더욱 증가, 중국 매출 비중은 2022년 평균 26%에서 2024년 40%로 확대
- SMIC/SwaySure/PST/SiEn/YMTC 등 미국이 블랙리스트로 지정한 5개 기업은 모든 글로벌 5대 기업의 상위 30대 고객에 포함
- 특히 ASML과 TEL과 같은 비미국계 장비사의 미국 블랙리스트 기업에 대한 매출은 2022~24년 사이 3배 이상 증가

글로벌 첨단 반도체 장비 기업: 중국 매출액



자료: 미 하원 대중 전략 경쟁 특별위원회 보고서(2025), 하나증권

글로벌 첨단 반도체 장비 기업: 중국 매출 비중



자료: 미 하원 대중 전략 경쟁 특별위원회 보고서(2025), 하나증권

미국 의존도 절대적으로 높았던 'EDA 툴' 자립 시도 가속화

- EDA 툴은 미국 기술 의존도 높아 기술 자립 시급했던 영역 중 하나, 미국 기업 글로벌 점유율 70% 이상으로 기술 장악력 압도적
- Primarius/Xpeedic/Empyrean/화웨이 주도로 자립화 시도, 현재 60여개 기업에서 상위 기업 중심으로 구조조정되며 역량 집중 중
- 현재 중국은 5~7nm 공정 진입 시도 중, 기업별로 개발 중인 기술이 분산되어 있어 첨단 칩 설계를 위해 기술 통합 필요한 상황

중국 EDA 툴 주요 기업 기술 개발 현황

기업명	주력 공정 범위	응용처
Empyrean (华大九天)	7nm(대형 디지털 SoC 전체 레퍼런스 제한적), 5nm(회로 시뮬레이터 등 일부 모듈 국한 추정)	전력반도체, 디스플레이, 통신 RF, 센서
Primarius (概伦)	7/5/3nm FinFET(전체 플로우 아닌 부분 커버 추정)	메모리, 전력반도체, 반도체 장비, MCU, 아날로그 SoC
Xpeedic (芯和)	7nm SMIC 등과 검증 완료, 5nm FinFET 패키지/EM 파운드리 검증	아날로그/RF 설계, EM 시뮬레이션, 2.5D/3D 패키징
X-EPIC (芯华章)	40/28nm 중심, 22/16nm로 파일럿 진입 시도	MCU/컨슈머 SoC 부분/전체 플로우
Qiyunfang (启云方)	PCB/회로도 보드 레벨 EDA	데이터센터/산업/통신용 PCB 설계 도구 (IC용 full 플로우 불가 추정)

자료: 각 사, 언론 보도, 하나증권

정부와 화웨이 주도로 개발 중인 'EUV 노광장비'

- 중국의 첨단 반도체 전공정 제조 장비 중에서 가장 기술 돌파가 시급한 영역은 EUV 노광장비 기술 개발
- 화웨이(SiCarrier/Yuliangsheng), 중국과학원, 대학 연구소 등이 핵심 축, EUV 광원/포토레지스트/장비 개발 초기 성과 확인
- 국산 DUV 장비 테스트 단계로 멀티패터닝 통해 5~7nm 진입 시도 중, 정부 주도로 SMIC 등 현장 실증 테스트로 상용화 촉진 중

중국 EUV 노광장비 관련 기술 개발 동향

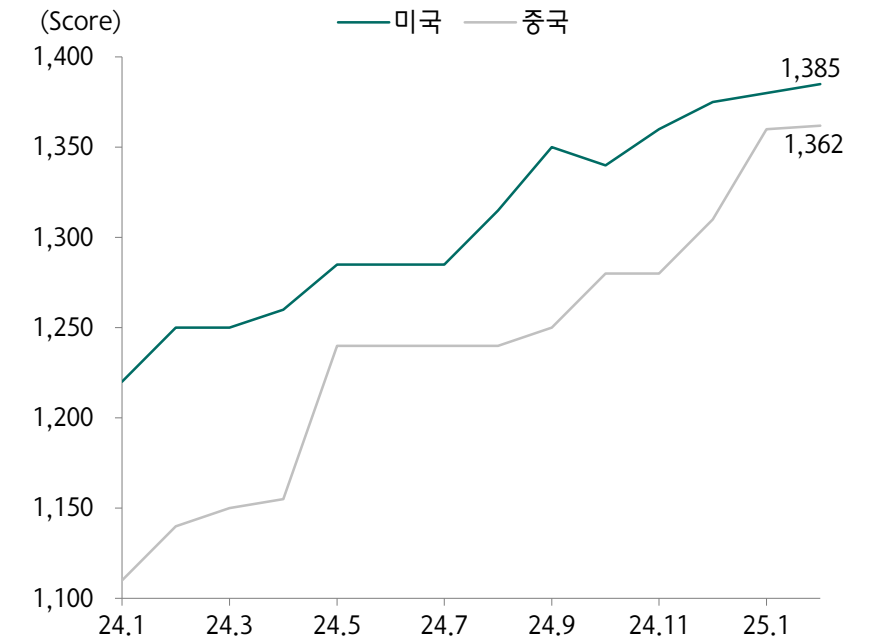
기술	공개 시점	개발 주체	개발 내용	특징
EUV 광원	2025.01 SCMP 보도	하얼빈 공대	LDP(방전 플라즈마) EUV 광원 개발	LPP 대비 높은 에너지 전환 효율, 낮은 원가, 낮은 기술 난도, EPGA 칩 수입 불필요
				한계: 파라미터 최적화, 방전 시간, 파워 출력
	2025.03 학술지 게재	상하이광학정밀기계연구소 (중국과학원 산하)	LPP(주석 플라즈마) EUV 광원 개발	전환 효율(CE) 3.42% 달성, 상용화(5.5%) 수준 50% 이상 도달, 자체 고체 상태 시스템 이론적 한계 6% 도달 주장; 연구 주도한 린난 박사는 ASML 광원 개발 과학자 출신, 전 세계 110건 이상 특허 보유
EUV 포토레지스트	2025.07 논문 게재	칭화대	폴리텔루륨 옥산 기반 EUV 포토레지스트 개발	고원자량 지닌 폴리텔루륨 옥산 기반, 고감도/고해상도/높은 EUV 흡수율 모두 충족
	2025.10 로이터 보도	Skyverse(화웨이 계열)	EUV 생산에 사용 가능한 포토레지스트 공개	주석 산화물 금속 클러스터 화학, 3nm~50nm 범위 패터닝 해상도 설명하는 여러 특허 출원
EUV 장비	2025.03 대만 언론 보도	화웨이 (중국과학원/화주오정밀기술)	3Q25 시범 양산, 2026년 대량 양산 목표	LDP 방식, 일부 글로벌 기관 65nm 수준 기술로 추정
	2025.09 FT 보도	SiCarrier(화웨이 계열)	내부 코드명 "Mount Everest"로 개발 중	EDA/첨단 테스트/EUV 관련 특허 등을 묶어 "새로운 반도체 무기고(arsenal)"를 구축 중

자료: 언론 보도, 하나증권

중국이 2025년부터 빠르게 격차 축소 중

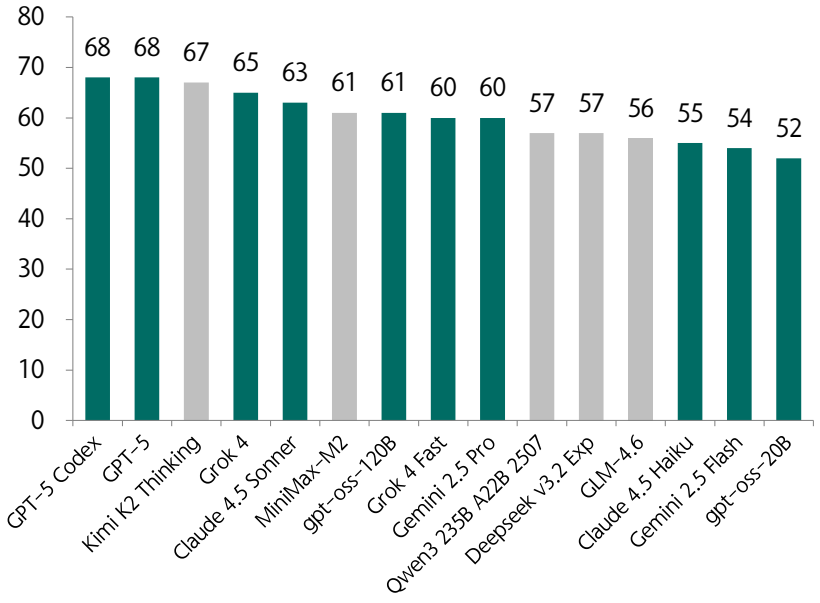
- 2024년 1월 기준 미국과 중국의 최상위 모델 성능 격차는 9.3% 수준이었으나, 2025년 2월 1년 만에 1.7%로 축소
- Artificial Analysis 순위에서 TOP 15에 진출하는 중국 모델 수는 빠르게 증가, 2024년 1개에서 22025년 11월 5개로 확대

LMSYS 챗봇 아레나 점수 - 미국 vs. 중국 상위 AI 모델 성능 변화



주: LMSYS(Large Model Systems Organization)의 'Chatbot Arena'는 미국 UC버클리 스카이랩이 개발한 글로벌 LLM 성능 비교 플랫폼
자료: LMSYS(2025), 하나증권

Artificial Analysis Intelligence Index 상위 15개 모델(2025.11)

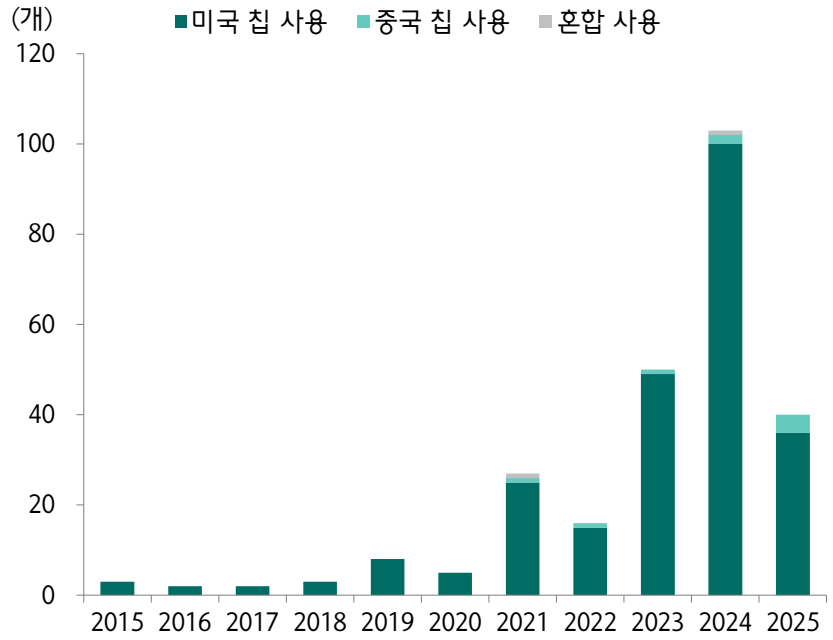


주: 회색 표기는 중국 모델, 초록색 표기는 미국 모델
출처: Artificial Analysis, 하나증권

중국 AI 모델의 한계점: 1) 훈련용 칩 미국 의존도 여전히 높은 상황

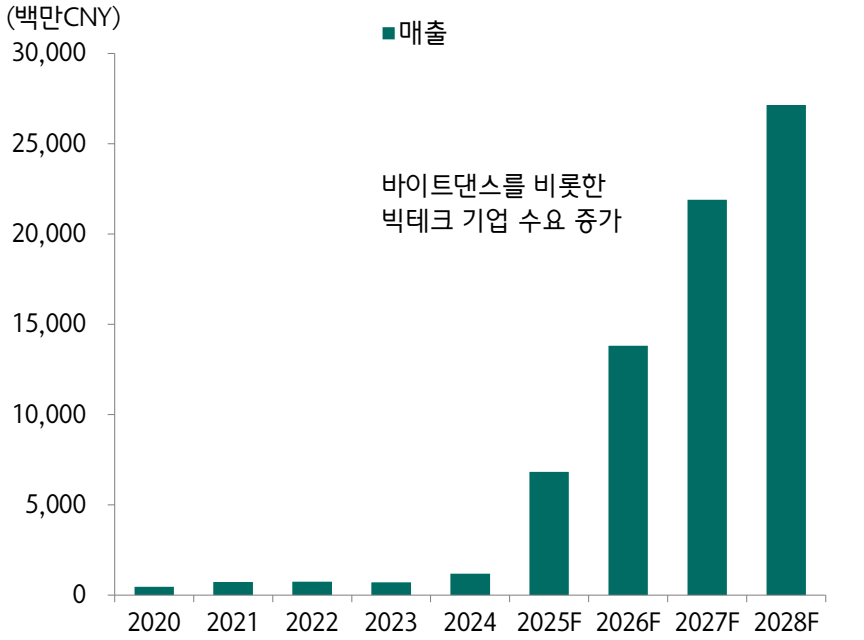
- 미국의 수출 통제에도 불구하고 중국의 주요 AI 기업은 대부분 엔비디아 칩을 클라우드를 통해 우회 사용 중인 것으로 추정
- 중국 AI 모델 중 90% 이상은 미국산 칩으로 훈련 중, 당분간 엔비디아의 훈련용 첨단 칩을 완전히 대체할 방안은 없어 보임
- 실제로 딥시크는 당국으로부터 로컬 칩 사용을 권고 받고 모델 훈련을 진행, 성능 한계로 신형 모델 출시가 연기된 바 있음

칩의 출처별 중국 AI 모델 개수 추이



자료: Epoch AI, 하나증권

중국 정부의 로컬 칩 사용 권고로 캠브리콘의 매출은 2025년부터 급증

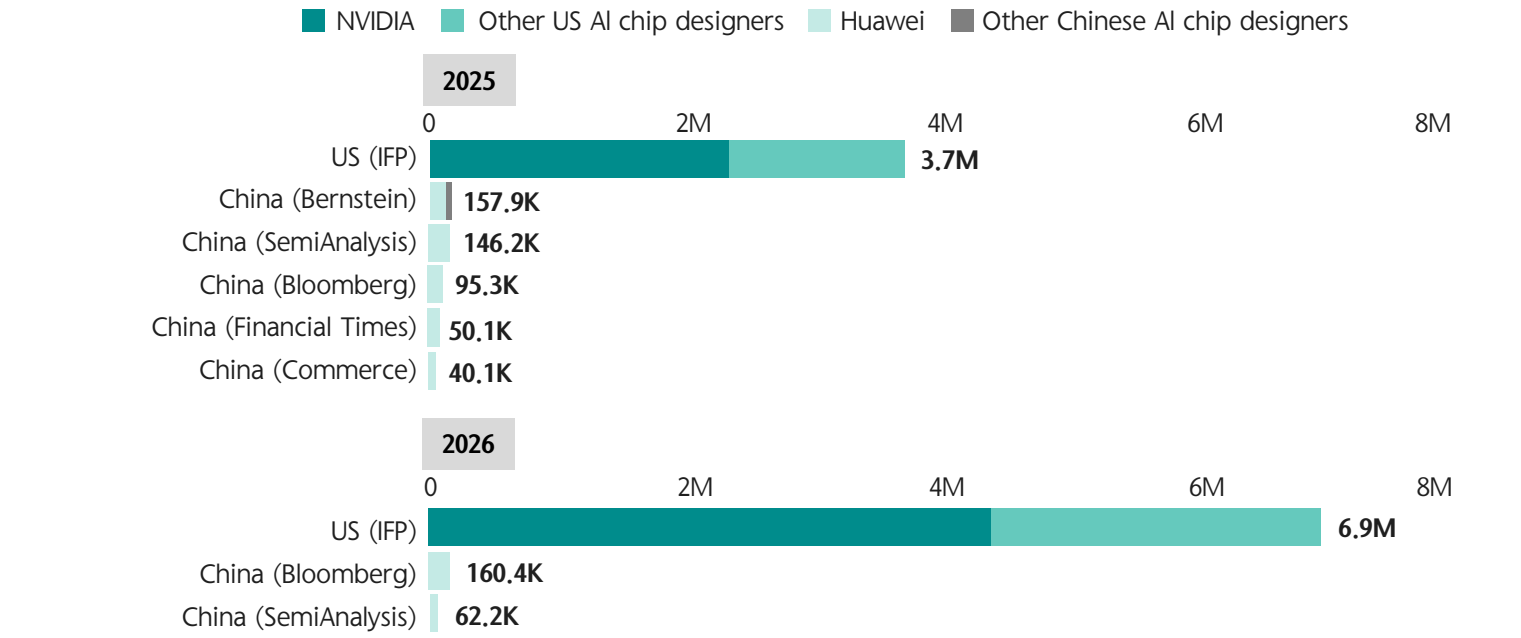


주: 캠브리콘(688256.CH)은 중국 AI 칩 설계 업체로 바이트댄스를 주요 고객사로 확보
자료: Bloomberg, 하나증권

중국 AI 모델의 한계점: 2) 컴퓨팅 역량 부족으로 인한 서비스 성능 제약

- 중국의 첨단 칩 부족과 클라우드 인프라의 한계로 인해 중국 모델의 실제 배포 성능은 미국 모델 대비 낮은 상황
- 딥시크의 경우 컴퓨팅 자원 절약을 위해 R1 모델을 의도적으로 낮은 속도로 제공하고 있는 것으로 추정
- 향후 중국의 첨단 AI 칩 생산 확대로 인프라 환경과 사용자 경험이 개선된다면 AI 서비스 도입 속도는 가속화될 수 있을 것

2025-26년 미국 vs. 중국 AI 칩 생산량 전망

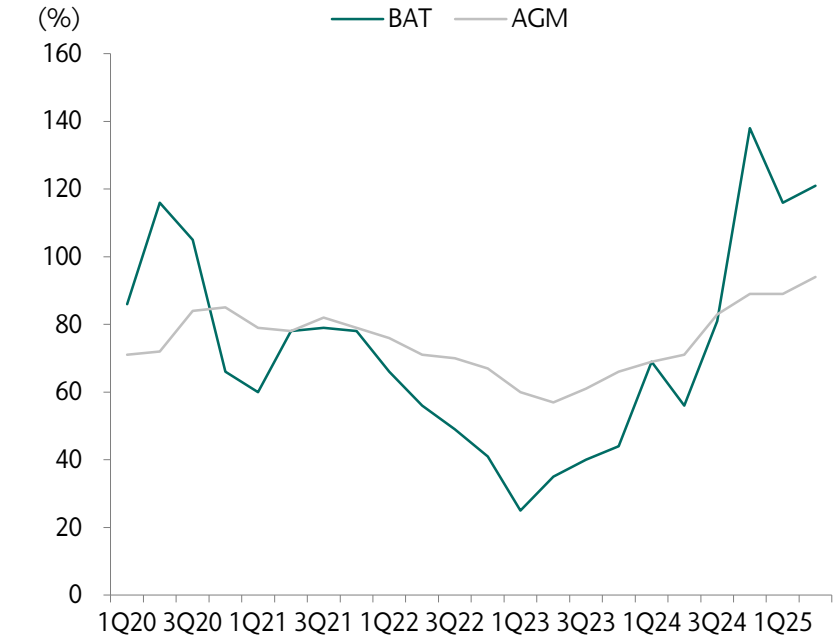


자료: Authors, 하나증권

중국 빅테크 기업은 2024년부터 Capex 규모를 대폭 확대 중

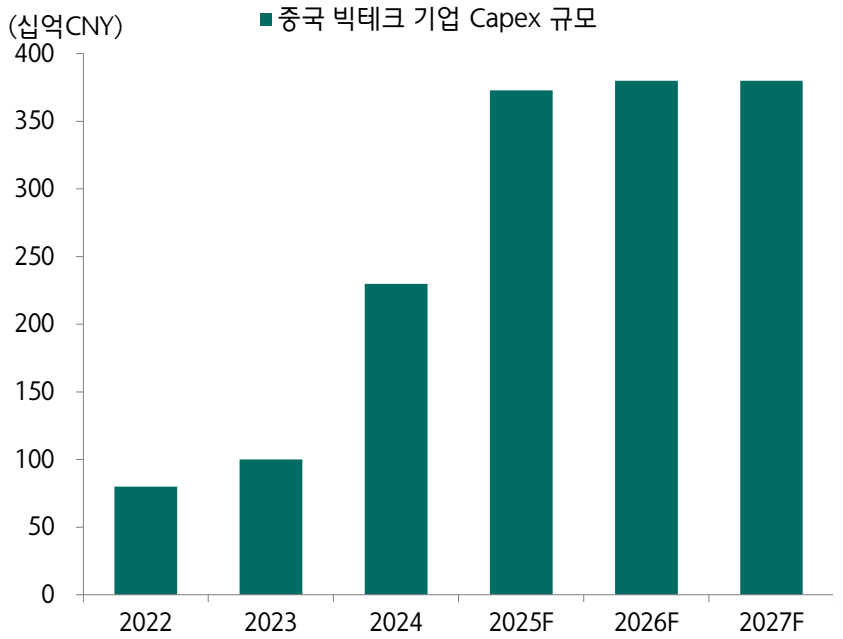
- BAT(바이두/알리바바/텐센트)의 Capex 증가율은 4Q24 이후 YoY +100% 이상 증가, 미국 빅테크 기업 증가율을 상회
- 알리바바는 올해 초 Capex 투자 가이던스를 향후 3년 3,800억위안으로 제시했으며, 최근 가이던스 상향을 예고

중국/미국 주요 빅테크 기업 Capex 증가율 추이



주: BAT는 바이두/알리바바/텐센트, AGM은 아마존/구글/마이크로소프트
출처: 각사 공시, 하나증권

중국 주요 빅테크 기업 Capex 추이

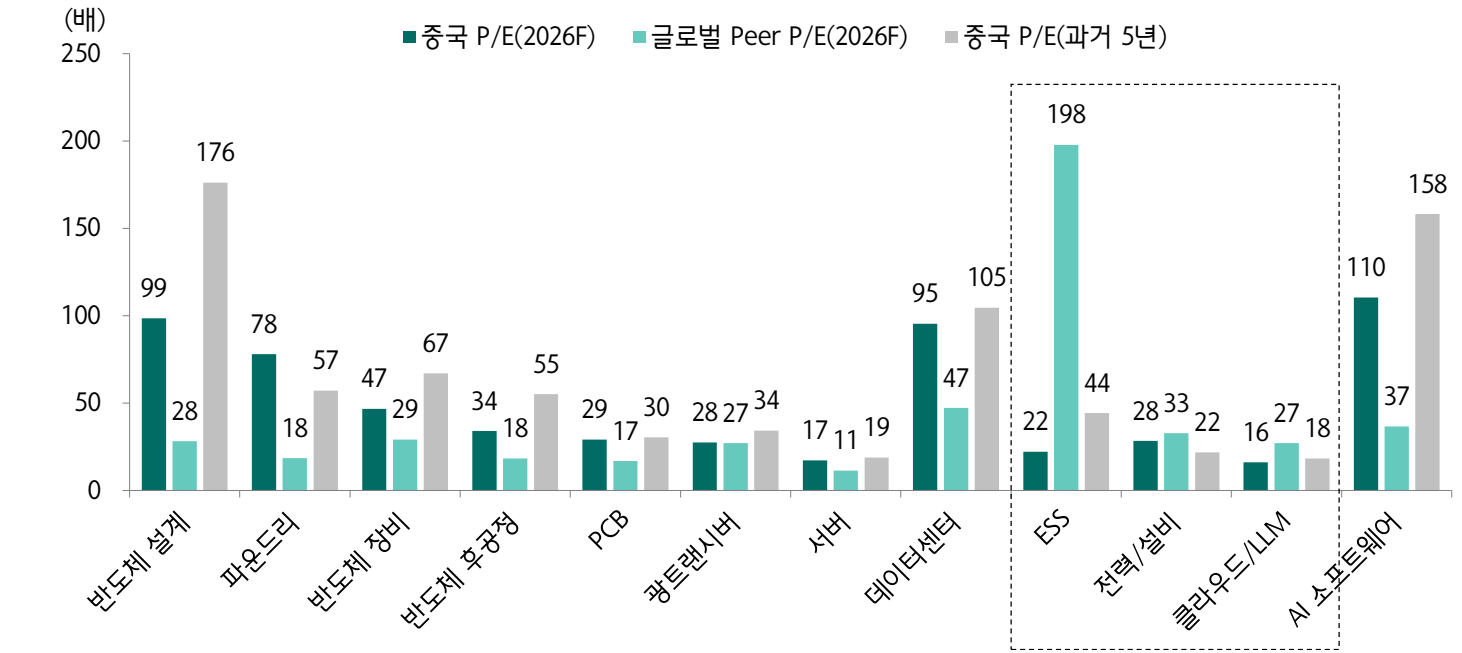


주: 바이트댄스, 알리바바, 텐센트, 바이두, 콰이쇼우, 메이탄 등 중국 주요 빅테크 기업 Capex 총합
출처: Bloomberg, 하나증권

2026년 중국 AI 테마는 ESS/전력·설비/클라우드(LLM) 업종 중심 추천

- ESS/전력·설비/클라우드(LLM) 업종은 1)향후 3년 견조한 실적 성장이 전망되고, 2)글로벌 Peer 대비 저평가 상태로 투자 매력 높음
- 올해 반도체 국산화 기대감에 따른 주가 랠리로 글로벌 Peer 대비 크게 고평가된 팹리스/파운드리 업종은 장기적 관점 접근 필요
- ESS/전력 섹터는 CATL/CGN Mining/Sieyuan, SW 업종은 알리바바/콰이쇼우, 그 외 반도체 장비/광모듈 상위 기업 투자 추천

2026년 견조한 실적과 저평가 매력 높은 AI 세부 업종 투자 매력 유효



주: 12M 선행 기준
자료: Bloomberg, 하나증권

중국 AI 산업 추천 종목 리스트

업종	기업명	티커	투자 포인트
ESS	CATL	300750 CH/ 3750 HK	• 전력망의 안정성을 위한 ESS 수요는 정전 위험 방지 차원에서 더욱 중요해질 전망 • 저품질 중심에서 고품질 배터리로의 전환에서 중국 내 ESS 점유율 약 10%에서 향후 3년 내 50% 이상으로 확대 전망
	Sungrow	300274 CH	• 태양광 인버터, ESS 기업으로 최근 미국 클라우드 기업들의 데이터센터 ESS 장착 프로젝트 수요 급증 • 유럽과 중국 시장 역시 재생에너지 확대 및 정책 지원에 힘입어 높은 성장세를 유지
전력/설비	CGN Mining	1164 HK	• 중국 국유 원전 운영사 CGN 계열로, 우라늄 자원·연료 플랫폼 역할을 수행하는 전략적 핵심 기업 • 글로벌 원전 확대에 따른 수요 증가, 2026~2028년 가격 현실화, 자산 주입 가능성이 실적 개선 모멘텀으로 작용할 전망
	Sieyuan Electric	002028 CH	• 중국의 대표적인 종합 전력망 장비 공급업체로 높은 진입장벽과 수익성을 갖춘 전압 GIS 부문에서의 경쟁력 우수 • 국가전망공사 입찰에서의 점유율 확대 기대, 다변화된 해외시장 성장을 통해 수익성 개선 여력 충분하다는 점에서 긍정적
	Huaming Equipment	002270 CH	• 중국 변압기 선두기업으로 해외 매출 비중(2024년 29%)이 동종업체 대비 높고, 데이터센터 수주 경쟁력을 갖추고 있음 • 전방산업의 Capex 확대, 충분한 CAPA, 연구개발 강화로 데이터센터 매출 '26년 전체 매출의 20%를 차지할 것으로 예상
	Jinpan Technology	688676 CH	• 중국 최대의 탭 체인저 제조업체(중국 내 점유 약 60%) • 1) 변압기 및 탭 체인저 수요 증가, 3) MR사(독일 탭 체인저 제조사)의 긴 납기에 따른 수요 이전으로 점유율 확대 전망
AI 소프트웨어	Alibaba	BABA US/ 9988 HK	• 중국 빅테크 상장사 중 가장 강력한 AI 모델 보유, 막강한 자금력과 생태계를 기반으로 중국 AI 시장을 선도할 것 • 올해 초부터 알리바바는 일부 AI 모델을 자체 개발한 칩을 사용해 훈련 중, 향후 이를 통한 AI 모델 경쟁력 강화 예상
	Tencent	700 HK	• 자사 생태계 응용에 맞춘 실용적 AI 개발 접근, 게임과 광고의 AI 적용과 2C AI 애플리케이션(위챗, Yuanbao)에 강점 • 전 사업 영역에서 구조적 성장세를 유지하면서 운영 레버리지 개선과 효율적 자본 집행을 통해 중장기 수익성 강화 예상
	Kuaishou	1024 HK	• AI 비디오 모델 Kling이 신성장 동력으로 부상, 성능은 글로벌 상위권 수준, 글로벌 유저 2천만명 돌파 • 최근 버전 업데이트 효과는 4분기부터 반영, Kling의 연간 매출 가이던스는 연초 예상치의 2배인 1.3억USD로 상향 조정
	Meitu	1357 HK	• AI 시각 디자인 에이전트 RoboNeo 출시 첫달 MAU 100만명 돌파, 유료 구독자 침투율 중장기 10% 목표 • 고마진 구독형 비즈니스 성장과 비용 효율화로 영업 레버리지 개선 예상, 알리바바와 협력하는 신규 비즈니스 모델 기대
반도체 장비	북방화창	002371 CH	• 식각, 증각, 세정, 열처리 공정에 반도체 전공정 장비를 생산, 중국의 반도체 장비 국산화를 이끌고 있는 대표적인 기업 • 메모리 업체의 공격적 증설과 SMIC의 로컬 장비 구매 본격화로 올해 장비 수요 견조할 것으로 전망
광트랜시버	InnoLight	300308 CH	• AI 트렌드 속에서 800G, 1.6T 광모듈 수요는 높은 수준에서 지속적으로 확대될 전망 • 2026~2027에는 1.6T 광모듈을 대규모로 배치할 예정, 고마진 제품 양산 및 출하가 본격화되면서 매출 및 이익 확대 기대.

Compliance Notice

본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.